

开源证券股份有限公司
关于深圳和美精艺半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书

保荐机构（主承销商）



（陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

声 明

保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《深圳和美精艺半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
第一节 本次证券发行基本情况	3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍	3
二、发行人基本情况	4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况	5
四、保荐机构内部审核程序和内核意见	6
第二节 保荐机构承诺事项	8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见	9
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论	9
二、发行人关于本次证券发行的决策程序	9
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件	9
四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件	11
五、发行人符合科创板定位要求	12
六、保荐机构对发行人的财务专项核查情况	15
七、根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规对发行人股东是否存在私募投资基金的核查情况	15
八、发行人存在的主要问题和风险	17
九、关于有偿聘请第三方行为的专项核查意见	24
十、对发行人发展前景的评价	25
十一、关于发行人审计截止日后经营状况的核查情况	28

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）。

（二）保荐代表人、项目组成员

1、保荐代表人情况

（1）保荐代表人姓名

王泽洋、宋江龙。

（2）保荐代表人保荐业务执业情况

本次发行项目的保荐代表人为王泽洋和宋江龙，其保荐业务执业情况如下：

王泽洋先生，开源证券投资银行总部副总经理，保荐代表人，北京理工大学工学硕士，曾就职于国海证券、太平洋证券，10 年以上投资银行经验。曾主持或参与了华源控股、兴瑞科技、清溢光电、航宇科技、古鳌科技等 IPO 项目；鼎汉技术、宝莱特、威华股份等再融资项目，华源控股重大资产重组项目及众多企业的改制重组等项目。王泽洋先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

宋江龙先生，开源证券投资银行总部执行董事，保荐代表人，注册会计师，中南财经政法大学管理学硕士，曾在国海证券、东兴证券从事投行业务。曾参与项目：航宇科技、华源控股等 IPO 项目；威达集团、艾格生物、万达重工、邦力达等新三板项目。宋江龙先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、项目协办人

本次发行项目的项目协办人为王越，其保荐业务执业情况如下：

王越先生，会计学专业，开源证券投资银行总部高级经理，曾就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。曾参与佳华科技（688051.SH）、步科股份（688160.SH）、中微半导

(688380.SH)、五方光电(002962.SZ)、玮言服饰等 IPO 项目工作,具备丰富的资本市场经验。王越先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

3、其他项目组成员

本次发行项目的其他项目组成员:唐汶金、杨颖然、段永琴、王颖轩、冯玥淇、巫秀芳、闫力扬、许凯丹、林彤。

4、联系方式

联系地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层,联系方式:029-88365835。

二、发行人基本情况

发行人	深圳和美精艺半导体科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Hemei Jingyi Semiconductor Technology Co., Ltd.
注册资本	17,746.50 万元
法定代表人	岳长来
有限公司成立日期	2007 年 6 月 28 日
整体变更为股份公司日期	2020 年 12 月 7 日
住所	深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区牛眠岭新村 26 号二楼
邮政编码	518117
电话	0755-89944891
传真	0755-89947648
互联网网址	http://www.hmjy-ic.com
电子邮箱	HMJY@hmjy-ic.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
信息披露和投资者关系负责人	刘绍林
信息披露和投资者关系负责人电话	0755-89942850

业务范围	一般经营项目是：超薄精密线路板的研发、生产（不含电镀、线路板蚀刻，不含列入国家《产业结构调整指导目录》限制及淘汰类的项目）；超薄精密线路板的销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；设备租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
本次证券发行类型	人民币普通股（A股）
发行股数、占发行后总股本的比例	公司首次公开发行股份总数不超过5,915.50万股且不低于本次公开发行后总股本的25%。本次发行不涉及原股东发售股份情况
拟上市的证券交易所及板块	上海证券交易所科创板

三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况

截至本发行保荐书签署日，开源证券及其关联方与发行人之间的关系及主要业务往来情况如下：

1、根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规的规定，发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司，将参与本次发行战略配售，并对获配股份设定限售期，具体认购数量、金额等内容在发行前确定并公告。

除上述情况外，开源证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方，不存在持有开源证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、开源证券的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况；

4、开源证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方，不存在相互提供担保或者融资的情况；

5、开源证券与发行人之间不存在其他关联关系。

除本次发行外，开源证券及其关联方与发行人及其关联方之间不存在影响本次发行的其他利害关系及其他业务往来。

四、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）关于首次申报的内部审核程序

1、第一阶段：项目的立项审查阶段

业务部门负责人首先对项目组提交的立项申请材料进行审核。质量控制部对立项申请材料进行初审后，安排召开立项会议。立项委员会参会委员在会议上就关注问题向项目组进行询问，并提出专业意见和建议。参会立项委员三分之二及以上同意的项目为立项通过。

2、第二阶段：项目的管理和质量控制阶段

保荐代表人对尽职调查的情况及工作底稿进行全面复核，确保项目的所有重大问题已及时发现并得以妥善解决。质量控制部对项目材料进行审核并安排现场核查，并将初审意见反馈给项目组。项目组应落实初审意见，修改报送材料相关文件，并将落实情况反馈给质量控制部。质量控制部原则上应在收到项目组修改的相关材料后的2个工作日内完成补充审核工作。

业务部门申请启动内核会议审议程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集，并提交质量控制部验收。验收通过的，质量控制部应当制作项目质量控制报告，列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论。验收未通过的，不得启动内核会议审议程序。

3、第三阶段：项目的内核审查阶段

内核管理部对申报材料按照开源证券内核工作相关要求就文件的齐备性、完整性和有效性进行核对，申报材料应按证券监管部门相关信息披露规定制作，并保证完整性和齐备性。

内核管理部根据项目类别对应问核文件，组织对问核对象进行问核，并就问核情况发表意见，完成问核后，签字保荐代表人应在问核文件上签字确认，签字确认的问核文件是申请召开内核会的必备要件之一。

内核审议应当在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量

控制报告，重点关注审议是否符合法律法规、规范性文件等的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的，应提出书面反馈意见。

内核管理部应当对意见的答复、落实情况进行审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。

（二）保荐机构内核意见

开源证券于 2023 年 11 月 22 日召开内核会议，对深圳和美精艺半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目申请文件进行审议。本次应参加内核会议的内核委员人数为 7 人，实际参加人数为 7 人，达到规定人数。

经审议，本次内核会议 7 票同意表决通过，会议认为：和美精艺符合首次公开发行股票并在科创板上市的条件，其证券申请文件真实、准确、完整，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定，不存在重大的法律和政策障碍，同意推荐深圳和美精艺半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。

第二节 保荐机构承诺事项

保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

一、保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书；

二、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上交所有关证券发行并上市的相关规定；

三、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

四、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

五、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

六、保证保荐代表人及其他项目组成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

七、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

八、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

九、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，并接受上海证券交易所的自律监管；

十、中国证监会和上交所规定的其他事项。

第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论

保荐机构根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《注册管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，由项目组对和美精艺进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目经过了必要的核准，市场前景良好，其顺利实施，预期能够产生较好的经济效益，有利于进一步促进发行人的发展；发行人具备了相关法律、法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。因此，保荐机构同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、发行人关于本次证券发行的决策程序

2023年10月24日，发行人召开第一届董事会第16次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》及其他相关议案。

2023年11月10日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》及其他相关议案。

依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市已履行了完备的内部决策程序。

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件

经保荐机构逐项核查，发行人符合《证券法》规定的公司公开发行新股的条件：

（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人严格按照《公司法》《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件

的要求设立了股东大会、董事会、监事会以及开展日常经营业务所需的其他必要内部机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员，并依法建立健全了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度。

发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的规定。

（二）发行人具有持续经营能力

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕3-451号《审计报告》，报告期内，发行人营业收入分别为18,901.07万元、25,369.54万元、31,199.87万元以及16,228.72万元，归属于母公司所有者的净利润分别为3,687.13万元、1,924.70万元、2,932.36万元以及1,520.97万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为3,364.32万元、1,843.16万元、2,077.04万元以及1,194.37万元。

发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项的规定。

（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人最近三年的财务会计报告出具标准无保留意见的天健审〔2023〕3-451号《审计报告》，发行人符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。

（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，发行人符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。

（五）发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

发行人符合经国务院批准的证券监督管理机构规定的其他条件，发行人符合《证券法》第十二条第（五）项的规定。

四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件

（一）本次发行申请符合《注册管理办法》第十条的规定

发行人前身和美有限成立于 2007 年 6 月 28 日，并于 2020 年 12 月 7 日按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。发行人为依法设立的股份有限公司，且持续经营 3 年以上，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

发行人符合《注册管理办法》第十条的规定。

（二）本次发行申请符合《注册管理办法》第十一条的规定

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的天健审〔2023〕3-451 号《审计报告》。

发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证发行人运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的天健审〔2023〕3-452 号《内部控制鉴证报告》。

发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定。

（三）本次发行申请符合《注册管理办法》第十二条的规定

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

1、发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；

2、发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；

3、发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

发行人符合《注册管理办法》第十二条的规定。

（四）本次发行申请符合《注册管理办法》第十三条的规定

发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

报告期内，发行人董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定。

五、发行人符合科创板定位要求

（一）发行人符合科创板行业领域的核查情况

发行人主营业务为 IC 封装基板的研发、生产及销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所处行业属于“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3982 电子电路制造”；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，发行人主营产品属于“1.新一代信息技术产业-1.3 电子核心产业-1.3.1 集成电路-集成电路材料-封装材料”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人所处行业为“1.2.1 新型电子元器件及设备制造-3982 电子电路制造-新型连接元件、高密度互连印制电路板、特种印制电路板、柔性多层印制电路板”，属于国家重点支持的战略性新兴产业。

因此，保荐机构认为，发行人属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条第（一）项“新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、

软件、互联网、物联网和智能硬件等”重点推荐领域的企业。

（二）发行人符合科创属性要求的核查情况

序号	科创属性评价标准	是否符合	符合指标情况
1	最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元	是	最近三年，发行人累计研发投入6,139.70万元，占最近三年累计营业收入比例为8.14%
2	研发人员占当年员工总数的比例 $\geq 10\%$	是	截至2022年12月31日，发行人研发人员数量为70人，占员工总数的比例为13.18%
3	应用于公司主营业务的发明专利 ≥ 5 项	是	截至本发行保荐书签署日，发行人形成主营业务收入的发明专利为16项
4	最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$ ，或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿	是	最近一年，发行人营业收入为31,199.87万元，最近三年营业收入复合增长率为28.48%

（三）发行人符合国家产业政策的说明

2017年2月，国家发改委印发的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》中，“封装材料”被列为战略性新兴产业重点产品和服务。2018年11月，国家统计局印发的《战略性新兴产业分类（2018）》，将“新一代信息技术产业”列为战略新兴产业。

2020年9月，国家发改委、科技部、工信部、财政部联合印发《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》将“电子封装材料领域”列为聚焦重点产业投资领域。同年，在国务院发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》中，明确指出“聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术等的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制”。

2021年1月，工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，指出“重点发展高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板”。

2022年10月，国家发改委与商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，将“刚挠印刷电路板及封装基板”列为鼓励外商投资产业。

综上，发行人主营产品IC封装基板是半导体芯片封装环节的重要材料，发

行人符合国家产业政策支持方向。

（四）保荐机构关于发行人符合科创板定位要求的核查结论

1、核查程序

针对发行人符合科创板定位，保荐机构执行了以下核查程序：

（1）查阅发行人工商登记的经营范围；

（2）查阅国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》等产业分类目录、规划或指南的规定，核查发行人所属行业的划分依据；

（3）查阅分析相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等；

（4）通过公开渠道查询发行人同行业可比公司招股说明书、定期报告等资料，了解其主营业务、主要产品以及行业分类情况；

（5）将发行人所属行业与《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中的重点推荐领域进行比对；

（6）对发行人报告期内的累计研发投入、研发人员数量及划分标准、营业收入及增长情况等进行了核查；

（7）查阅发行人专利证书，获取专利查册证明；核查发行人发明专利数量、发明专利在主营业务中的应用情况；

（8）将发行人的研发投入、研发人员、发明专利、营业收入等指标与《科创属性评价指引（试行）》相关指标进行逐一比对核实；

（9）核查发行人出具的《深圳和美精艺半导体科技股份有限公司关于科创属性符合科创板定位要求的专项说明》并针对发行人符合科创板定位要求出具专项核查意见。

2、核查结论

经核查，本保荐机构出具了《开源证券股份有限公司关于深圳和美精艺半

导体科技股份有限公司符合板块定位要求的专项意见》，认为发行人符合国家产业政策要求、科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标或情形等科创板定位要求。

六、保荐机构对发行人的财务专项核查情况

根据《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知》《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》的有关要求，保荐机构对发行人报告期内会计信息开展了全面核查工作，对发行人报告期内可能造成粉饰业绩或财务造假的重点事项履行了必要的核查程序，确保发行人财务会计信息的真实性。

财务核查过程中，保荐机构采用对主要客户及供应商进行走访和执行函证程序，获取并查阅主要客户及供应商企业信用公示信息、发行人银行账户流水、账簿明细及原始单据等文件，综合运用控制测试、细节测试、分析性复核等措施对发行人报告期财务会计信息进行了全面核查。

经核查，保荐机构认为，发行人内部控制制度健全合理，收入及盈利真实，不存在人为调节、粉饰业绩等财务造假情形。

七、根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规对发行人股东是否存在私募投资基金的核查情况

保荐机构对发行人股东中机构投资者是否有属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金、是否按规定履行备案程序进行核查。

（一）核查方式

保荐机构通过获取并查阅发行人股东中机构股东的营业执照、《公司章程》或《合伙协议》，查阅中国证券投资基金业协会网站，与发行人律师进行沟通等方式，对发行人机构股东是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金进行核查，并获取了符合规定的私募股权投资基金的备案证书及其管理人的登记资料等相关文件，核查私募股权投资基金及其管理

人是否依法履行私募投资基金备案程序和登记程序。

（二）核查结果

经核查，发行人部分股东为私募投资基金，相关股东均已按照《私募投资基金登记备案办法》等法律法规的规定依法办理了备案手续，具体情况如下：

序号	股东名称	基金备案情况	管理人信息
1	达晨创通	已于2018年4月完成私募基金备案（编号：SCQ638）	达晨财智（登记编号：P1000900）
2	祥禾涌骏	已于2021年8月完成私募基金备案（编号：SSN082）	上海涌铎投资管理有限公司（登记编号：P1003507）
3	鸿富星河	已于2020年11月完成私募基金备案（编号：SNA220）	红土智能（登记编号：P1065050）
4	人才基金	已于2018年5月完成私募基金备案（编号：SCY331）	红土创投（登记编号：P1007124）
5	中小基金	已于2017年2月完成私募基金备案（编号：SR2284）	深圳国中创业投资管理有限公司（登记编号：P1060025）
6	达晨创鸿	已于2020年9月完成私募基金备案（编号：SLV980）	达晨财智（登记编号：P1000900）
7	东莞辰星	已于2020年4月完成私募基金备案（编号：SJX714）	东莞市三藏资产管理有限公司（登记编号：P1032418）
8	洛盈华盛	已于2020年7月完成私募基金备案（编号：SJS071）	深圳华融胜资本管理有限公司（登记编号：P1070175）
9	东莞德彩	已于2020年9月完成私募基金备案（编号：SLH797）	广东德彩股权投资基金管理有限公司（登记编号：P1068641）
10	河南中创信	已于2017年10月完成私募基金备案（编号：SW2368）	深圳中创信股权投资基金管理有限公司（登记编号：P1063385）
11	泰达盛林	已于2020年7月完成私募基金备案（编号：SGE219）	天津泰达科技投资股份有限公司（登记编号：P1001349）
12	东证锦信	已于2021年11月完成私募基金备案（编号：SNB385）	东证锦信投资管理有限公司（登记编号：GC2600030844）
13	格金广发	已于2019年7月完成私募基金备案（编号：SGC728）	广发信德投资管理有限公司（登记编号：PT2600011589）
14	格金三号	已于2020年12月完成私募基金备案（编号：SNB292）	格力投资（登记编号：P1065730）
15	深创投	已于2014年4月完成私募基金备案（编号：SD2401）	深创投（登记编号：P1000284）
16	陕西芯合	已于2021年12月完成私募基金备案（编号：STC718）	陕西科技创业投资管理有限公司（登记编号：P1002850）
17	中洲铁城	已于2018年11月完成私募基金备案（编号：SEA636）	前海长城基金管理（深圳）有限公司（登记编号：P1023212）
18	中经力合	已于2022年6月29日完成私募基金备案（编号：SVW786）	深圳市力合科创创业投资有限公司（登记编号：P1066368）
19	高新投怡化	已于2021年11月完成私募基金备案（编号：SSX790）	深圳市高新投怡化股权投资基金管理有限公司（登记编号：P1068237）

此外，深圳中咨旗不属于私募基金，但属于私募基金管理人，其于 2018 年

2月11日完成登记，登记编号为P1067294。

发行人的机构股东中，除上述19名机构股东为私募投资基金外，其余机构股东均不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》认定的私募投资基金，无需履行备案登记手续。

八、发行人存在的主要问题和风险

（一）与发行人相关的风险

1、技术风险

（1）技术革新风险

发行人主营业务为IC封装基板的研发、生产与销售，该行业属于技术密集型产业，企业须持续开展研发投入及工艺改进，以提升核心竞争力，助力企业稳健发展。

在境外市场，欣兴电子、南亚电路、揖斐电、三星电机等企业在IC封装基板领域深耕多年，具备丰富的技术积累；而在境内市场，深南电路、兴森科技等企业亦凭借其产品和资金等优势，纷纷布局IC封装基板领域。因此，发行人只有坚持创新、不断提升自身技术水平，才能在中高端IC封装基板市场占据一席之地。但考虑到未来市场变化、技术变革及发行人自身研发过程存在的各种不可预见因素等，若发行人未来无法保持在产品和技术工艺等方面的持续突破，发行人将面临产品研发与工艺技术落后的风险。

（2）研发未取得预期效果的风险

IC封装基板行业属于技术密集型产业，为巩固和提升市场竞争地位，发行人持续保持较高的研发投入。报告期内，发行人各期研发投入分别为1,312.17万元、2,291.16万元、2,536.37万元和1,186.19万元，占营业收入的比例分别为6.94%、9.03%、8.13%和7.31%。而相关技术成果需要在市场转化过程中接受严格的检验，如果发行人在研发过程中未能实现关键技术的突破，或相关技术无法实现产品化、商业化，则发行人可能面临研发投入未取得预期效果的风险。

（3）技术泄密和核心技术人员流失的风险

经过多年的自主研发和技术创新，发行人积累了多项专利与核心技术，并

培养了一批经验丰富的技术人员。为保护发行人的核心技术，发行人采取了严格的保密措施，与核心技术人员签署了保密协议、竞业限制协议等，并通过申请专利、集成电路布图设计等方式进行有效保护。

但随着国内众多企业纷纷布局 IC 封装基板领域，该行业对技术人才的争夺日益加剧。若发行人未来不能在薪酬、福利、人才培养等方面持续提供具有竞争力的待遇或激励措施，加之技术秘密保护措施存在局限性等因素，发行人可能面临核心技术人员流失、核心技术失密的风险。

2、经营风险

（1）客户集中度较高的风险

发行人的客户主要集中在华南地区，报告期内，华南地区客户产生的收入占比分别为 78.61%、62.01%、67.37%及 69.55%。如果相关客户的经营状况或市场竞争环境在未来发生重大不利变化，同时发行人无法有效拓展其他地区客户，发行人可能面临业绩下滑的风险。

此外，报告期内，发行人前五大客户产生的收入占主营业务收入的比例分别为 56.73%、53.53%、47.30%及 48.02%，若发行人未来与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营状况发生变化，从而降低对发行人产品的采购需求，将会对发行人的经营业绩造成不利影响。

（2）主要原材料价格波动风险

IC 封装基板的主要原材料为金盐和覆铜板，其占发行人主营业务成本的比例较高。报告期内，原材料占主营业务成本的比例分别为 61.25%、52.53%、51.46%及 47.95%。

金盐、覆铜板的价格受国际市场黄金、铜等大宗商品价格的影响较大，其价格波动对发行人的成本结构具有较大影响。未来若原材料价格出现大幅波动，而发行人不能通过价格传导或技术创新等措施有效化解原材料价格上涨的压力，抑或在原材料价格下跌趋势中未能做好存货管理，发行人的经营业绩将受到不利影响。

(3) 正基电子使用土地、厂房存在行政处罚、搬迁的风险

2006 年 6 月 30 日，正基电子与四方埔公司签署《合作协议书》，约定四方埔公司将金牛工业区的一块土地与正基电子合作办厂。截至本发行保荐书签署日，正基电子自建厂房尚未取得房屋权属证书。此外，根据深圳市规划和自然资源局发布的《深圳市 2020 年度城市更新和土地整备计划》，正基电子自建厂房所在地被划入“坪地四方埔社区土地整备利益统筹项目”，存在被拆除的风险。

虽然深圳市龙岗区规划土地监察局出具的《复函》载明“上述土地及建筑的建设和使用不属于重大违法、违规行为，我局无需对此进行立案处罚”、深圳市龙岗区城市更新和土地整备局亦出具《复函》载明“可通过优化分期，避免纳入首期拆除范围，从而确保 5 年内不予拆除”，但如果未来政策突然发生变化，则正基电子仍可能面临被行政处罚及搬迁的风险。

3、财务风险

(1) 固定资产折旧增加的风险

报告期各期末，发行人在建工程账面价值分别为 2,908.48 万元、4,956.14 万元、18,539.35 万元和 17,438.01 万元，占当期非流动资产的比例分别为 22.09%、18.36%、41.25%和 34.10%，若发行人未来经营无法有效实现固定资产投入的预期新增效益，则在建工程结转固定资产导致的折旧增加将对发行人经营业绩产生不利影响。

(2) 毛利率波动的风险

报告期各期，发行人的主营业务毛利率分别为 35.12%、24.34%、20.37%和 20.78%，存在一定幅度的波动。发行人的主营业务毛利率主要受市场供求关系、供应商及客户的议价能力、固定资产折旧等因素影响。

如果未来半导体行业整体情况发生重大不利变化、下游客户对 IC 封装基板的需求减弱、主要原材料价格大幅上涨、产能扩张导致折旧费用大幅增加，以及发生其他重大不利情况，可能导致发行人在未来一定时期内面临毛利率波动的风险。

（3）应收账款出现坏账损失的风险

报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 6,250.01 万元、9,649.14 万元、12,009.77 万元和 16,151.89 万元，占当期流动资产的比例分别为 27.20%、16.08%、23.01%和 32.25%；发行人应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 33.07%、38.03%、38.49%和 49.76%（经年化计算）。

随着发行人营业收入的快速增长，应收款项金额可能持续增加。若发行人主要客户出现违约等情形，将发生应收账款未能及时收回或无法收回的风险，进而对发行人的现金流和财务状况产生不利影响。

（4）政府补助及税收优惠政策变动的风险

报告期各期，发行人计入当期损益的政府补助金额分别为 323.74 万元、266.46 万元、534.22 万元和 222.93 万元，如果发行人未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，将会对发行人业绩产生不利影响。

发行人于 2020 年 12 月 11 日被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》（证书编号 GR202044202581），有效期 3 年。正基电子于 2020 年 12 月 11 日取得《高新技术企业证书》（证书编号 GR202044206482），有效期 3 年。江门和美于 2022 年 12 月 19 日取得《高新技术企业证书》（证书编号 GR202244001480），有效期 3 年。报告期内，发行人享受的高新技术企业税收优惠总额分别为 321.19 万元、154.40 万元、193.89 万元和 87.08 万元。如果国家对高新技术企业税收优惠政策发生变化，或者发行人与子公司无法通过高新技术企业复审或不再符合相关认定标准，发行人将不能再适用 15%的所得税优惠税率，且需要补缴按优惠税率缴税期间少缴的税款，这将导致发行人所得税税负上升，发行人的盈利水平将受到一定程度的影响。

（5）汇率波动的风险

报告期内，发行人外销收入占当期主营业务收入的比例分别为 6.08%、25.46%、13.76%和 13.00%，主要使用美元等外币进行结算。报告期内，受到宏观经济、地缘政治等多重因素影响，人民币兑外币的汇率波动显著，发行人的汇兑损益分别为 10.55 万元、-59.41 万元、-253.28 万元和 19.83 万元，占各期利润总额的比例较低。在人民币汇率波动的情况下，发行人以外币结算的出口销

售可能会造成汇兑损失，从而对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响。

4、内部控制风险

（1）规模扩张引发的管理风险

发行人已经按照有关法律法规和制度的要求，建立健全了各项内部控制制度，形成了相对完善的内部控制体系。内控制度的有效运行，保证了发行人经营管理活动的正常有序开展，并有效控制了风险。但随着发行人业务规模的持续扩大，经营管理、财务监控、资金调配等工作日益复杂，将对发行人的内部控制提出更高要求。如果发行人的内部控制体系不能随发行人业务的发展不断完善并得到有效执行，则可能对发行人的经营产生不利影响。

（2）控制权不稳定的风险

发行人控股股东、实际控制人岳长来直接持有发行人 4,896.76 万股股份，占发行人总股本的 27.59%。岳长来、朱圣峰（持股比例为 5.39%）、居永明（持股比例为 4.04%）、何福权（持股比例为 2.96%）签署一致行动协议，约定“自协议签署之日起至发行人股票上市之日起 36 个月内，朱圣峰、居永明、何福权作为发行人股东、董事行使权利时，应始终与岳长来保持一致的意思表示”。根据该协议，岳长来合计控制发行人发行前 39.98%的表决权份额。本次发行完成后，岳长来实际支配的发行人股份比例将被稀释。在目前的股权架构条件下，不排除上市后主要股东持股比例变动而对发行人的人员管理、业务发展和经营业绩产生不利影响的可能性。此外，实际控制人持股比例降低导致的控制权不稳定风险，如届时缺乏妥善的处理措施，可能对发行人的长期稳定发展造成不利影响。

5、法律风险

（1）部分生产经营场所为租赁取得的风险

江门和美、江苏和美、和美深圳分公司的生产经营场所为采取租赁方式取得，未来如果发生租赁协议到期无法续租的情形，前述分、子公司需要更换办公场地，可能会对发行人的正常经营造成不利影响；如果发生租金大幅上涨的情形，可能会对发行人整体的经营业绩造成不利影响。

(2) 安全生产与环保的风险

发行人主要产品生产过程中会产生少量废气、废水、废渣，如果处理不当，可能会对周围环境产生不利影响。随着监管政策的趋严、发行人业务规模的扩张，安全生产与环保压力同步增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全生产和环保事故风险。

一旦发生安全生产或环保事故，发行人不仅会面临直接损失，还会面临被有关监管部门处罚、责令整改或停产的风险，进而影响发行人正常生产经营。

6、募投项目实施风险

(1) 募集资金投资项目实施风险

发行人本次募集资金主要用于珠海富山 IC 载板生产基地建设项目（一期），该募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的。在发行人募集资金投资项目实施过程中，发行人可能面临市场变化、发行人组织管理和市场营销的执行情况未及预期、遭遇突发性事件等不确定风险，导致项目未能按计划正常实施，进而影响项目投资收益和发行人经营业绩。

(2) 募投项目实施后产能消化的风险

本次募集资金投资项目珠海富山 IC 载板生产基地建设项目（一期）系新增产能项目，如未来市场环境发生较大不利变化、下游客户需求增速低于预期，且发行人不能及时有效地开拓市场，消化新增的产能，则发行人或将无法按照既定计划实现预期的经济效益，从而对发行人业务发展产生不利影响。

(3) 募集资金投资项目实施后发行人折旧摊销增加的风险

发行人本次拟使用募集资金 60,000.00 万元用于珠海富山 IC 载板生产基地建设项目（一期），20,000.00 万元用于补充流动资金。本次募集资金投资项目实施后，发行人的固定资产和无形资产规模将有较大幅度的增长，折旧摊销费用也将相应增加。如果市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的实际收益不能消化新增的折旧和摊销费用，则发行人或将面临利润下滑的风险，进而对发行人未来业绩和财务状况产生重大不利影响。

（二）与行业相关的风险

1、行业政策变动风险

半导体产业是信息技术产业的基础和重要组成部分，国家对高质量发展半导体行业高度重视，相继出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等支持性政策。相关政策对支持行业内企业自主创新、做大做强发挥了重要作用，为行业内企业创造了良好的发展机遇。若未来国家对相关政策予以调整，对集成电路封装和测试行业或上下游行业的支持力度有所减弱，则或将对发行人的长足发展产生不利影响。

2、行业竞争加剧风险

在 IC 封装基板行业内，中国内资生产商较少，目前，行业主要市场份额仍被中国台湾、日本、韩国的厂商占据。预计在未来较长时期内，该行业仍将维持较为激烈的竞争格局。同时，随着下游应用领域竞争的加剧、产品价格的走低，IC 封装基板行业亦存在价格下降的风险。

根据中国台湾电路板协会统计，2022 年全球封装基板产值约为 178.4 亿美元，以厂商资金类别（含其在中国大陆等非其本土投资控股的工厂，以下相关统计均参照此口径¹）为基准，中国台湾为最大封装基板供应者，约占整体产值的 38.3%，其次为韩国与日本，三地厂商累计占据 90%以上的全球封装基板市场；中国内资厂商仅占整体产值约为 3.2%。与行业龙头企业相比，发行人在经营规模、市场占有率等方面均存在一定差距。随着国内 IC 封装基板企业的纷纷扩产，未来市场竞争或将进一步加剧，若发行人在生产管理、技术水平及产品质量等方面未能持续精进，则其经营业绩或将遭受不利影响。

3、国际贸易摩擦风险

发行人的部分产品存在对外出口情况，且部分国内客户的终端产品亦存在对外出口的可能性。报告期内，发行人出口业务收入分别为 1,143.58 万元、6,383.61 万元、4,265.97 万元和 2,088.49 万元，占主营业务收入的比例分别为

¹ 含其在中国大陆等非其本土投资的工厂：例如韩国 IC 封装基板的产值不仅包含其本土工厂产值，也包含其在全球范围内非其本土投资控股的工厂产值，即韩国厂商（资金类别）在全球范围内投资控股的 IC 封装基板厂商。

6.08%、25.46%、13.76%和 13.00%。随着国际局势的不断变化，不排除未来其他国家或地区对我国出口产品采取限制措施的可能。若国际贸易摩擦范围扩大或持续升级，抑或是其他进口国设置贸易壁垒，则可能阻碍发行人的海外销售，对发行人营业收入的增长带来不利影响。此外，发行人生产过程中所使用的油墨主要由日本太阳油墨株式会社供应，该公司是全球 IC 封装基板行业主要的油墨供应商，如果未来国际贸易摩擦程度加剧，则发行人可能面临原材料油墨进口受限的风险。

（三）其他风险

1、发行失败的风险

发行人本次发行能否顺利通过交易所审核并取得中国证监会同意注册的決定，以及取得同意注册批复的时间均存在不确定性。本次发行结果会受到发行时宏观经济环境、相关行业市场情况、投资者对发行人未来发展的评价等多种因素的影响；若本次发行未能足额认购，则存在发行中止甚至发行失败的风险。

2、净资产收益率及每股收益被摊薄的风险

本次发行完成后，发行人的净资产规模及股本总额将在短期内大幅增长。由于募集资金投资项目存在一定建设周期，且从投产到产生效益需要一定时间，因此，本次发行完成后，如果发行人的盈利增幅不达预期，则净资产规模及股本总额的扩大将导致发行人的净资产收益率和每股收益出现一定幅度的下降。

九、关于有偿聘请第三方行为的专项核查意见

根据中国证监会公告〔2018〕22 号《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等规定，保荐机构就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。

经核查，在本次发行上市过程中，发行人聘请开源证券担任保荐机构及主承销商，聘请北京市中伦律师事务所担任发行人律师，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、验资机构及验资复核机构，聘请中和资产评估有限公司担任资产评估机构。

除前述依法需聘请的证券服务机构之外，发行人另聘请北京尚普信息咨询有限公司提供募集资金投资项目可行性研究等服务，聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公司提供 IPO 底稿咨询及电子化服务、IPO 项目全流程信息化平台解决方案、报会咨询及材料制作支持服务，相关聘请行为合法合规。

除上述聘请行为外，保荐机构和发行人不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

十、对发行人发展前景的评价

（一）发行人所属行业的机遇

1、国家产业政策引导行业健康发展

半导体集成电路产业是我国优先发展的行业，是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。作为半导体集成电路重要的封装材料，IC 封装基板的发展得到了国家相关产业政策的大力支持。我国先后通过出台《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》等政策方针，将 IC 封装基板行业相关产品列为重点发展对象。2022 年 10 月，根据国家发展改革委与商务部发布的《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》，“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板等”被列为“鼓励类”发展产业。国家政策的扶持将进一步推动半导体集成电路产业的发展，为 IC 封装基板提供广阔的发展空间。

2、下游应用领域的不断发展

IC 封装基板广泛应用于消费电子、工业控制、通信、计算机、汽车电子和军事航空等领域，下游应用领域的快速发展为 IC 封装基板行业带来巨大的市场空间。近年来，随着 AI、5G 和自动驾驶等行业的爆发，市场对于高性能逻辑芯片和大容量存储芯片的需求有望持续提升，进而为 IC 封装基板行业带来全新的发展机遇。

3、国产化替代推动半导体产业发展

自 2018 年国际贸易摩擦加剧，国产化替代成为半导体行业的重要趋势。在半导体产业链封装测试环节中，中国大陆封装测试企业占据全球近三分之一的市场份额，而中国内资 IC 封装基板企业（不含外资在大陆厂商或外资控股厂商）占比全球市场份额仅为 3.2%。随着我国对半导体产业的大力支持和持续投入，国内半导体全产业链企业得到快速发展，IC 封装基板作为芯片封装的核心材料，国产化替代成为必然的发展趋势。

（二）发行人的竞争优势有助于其把握行业发展机遇

1、深厚的经验积累与持续的研发创新

发行人 15 年来始终深耕存储芯片封装基板领域，积累了丰富的产品和技术经验。目前，发行人 Tenting 制程量产能力达到线宽/线距 30/30 μm ，样品能力达到线宽/线距 25/25 μm ；mSAP 制程量产能力达到 20/20 μm ，样品能力达到线宽/线距 15/15 μm 。

发行人在做精做细存储芯片封装基板产品的同时，始终坚持自主创新，将研发方向聚焦在先进产品、先进工艺和智能制造等领域，并形成了自主可控的核心技术与知识产权。截至本发行保荐书签署日，发行人已获得专利 99 项，其中发明专利 16 项，并获得了国家工信部专精特新“小巨人”企业认定、广东省电子信息行业协会“大容量嵌入式存储芯片封装基板关键技术及应用-科技进步二等奖”、国家高新技术企业认定以及国家工业信息安全发展研究中心科学技术成果登记证书“大容量嵌入式存储芯片封装基板关键技术及应用-处于国内领先水平”。

2、丰富的产品系列与产品布局

发行人自设立以来始终重视自主创新和技术研发，经过多年发展，形成了以存储芯片封装基板为核心的产品体系，并逐步布局逻辑芯片封装基板等高端产品。目前，发行人的产品广泛应用于智能手机、消费电子、工业控制、通信、计算机、汽车电子等终端领域。发行人丰富的产品系列以及产品布局使发行人能够满足下游客户基于不同应用场景的多样化需求，把握行业各细分领域的增长机遇，有效防范过分依靠单一品类带来的市场风险。

3、优质且稳定的客户资源

发行人秉承“提供有竞争力的 IC 封装基板解决方案和服务，持续为客户创造最大的价值”的使命，历经超过 15 年的市场检验，凭借深厚的技术积累与可靠的产品质量，赢得了下游客户的广泛认可和市场口碑，如华天科技向发行人授予“2021 年度最佳支持供应商”，发行人的大容量嵌入式存储芯片封装基板获得客户佰维存储评价意见“产品性能稳定、良品率高，对比全球同类产品可达到领先水平”。

经过多年发展，发行人已与众多知名客户建立了长期、稳定的合作关系。发行人下游封测企业或终端厂对集成电路封测材料有较高质量要求，对供应商选择有较为严格的筛选、考核体系，且认证周期较长。因此，发行人认证通过并与下游封测企业建立起合作关系后，客户通常不会轻易更换供应商，双方合作稳定性较高，发行人的客户黏性较强。发行人的产品已通过众多国内外知名 IC 封测厂商的认证，如：京元电子、力成科技、华天科技、群丰科技、华泰电子、佰维存储、时创意、通富微电、沛顿科技、中电智能卡以及甬矽电子等。以上述厂商为代表的客户构成了发行人优质且稳定的客户资源优势。

4、优秀的品质管控及快速响应能力

发行人针对生产、品质检验两大环节制定了严格的品质管控制度，并保持一贯严格执行。生产环节中，由制造中心对影响产品品质的因素加以控制，使产品的生产过程保持稳定，从而确保产品的质量、交期满足客户需求。品质检验环节中，由品质中心检验产品并进行标识，使产品具有可追溯性。此外，下游封装测试厂商的生产成本受晶圆的价格波动影响较大，需要尽快完成芯片封装并交货，因此 IC 封装基板的交期对其尤为重要，发行人产品的按时交付能够保证下游客户生产计划的顺利进行，有助于其提高生产效率并有效控制生产成本。

通过制定并严格执行上述生产、质检制度，发行人得以在保证产品品质的前提下快速响应客户需求，于交期内交付产品。报告期内，发行人不断提高品质管控及交期响应能力，发行人的产品品质及订单响应速度受到了下游客户的广泛认可。

5、稳定的管理团队及核心技术人员

发行人创始管理团队均为电子电路行业内的资深人士，核心团队主要成员从发行人创立初期即任职于发行人，具有多年的 IC 封装基板领域技术积累和丰富的管理工作经验，发行人的技术研发及经营战略紧跟行业发展方向。目前，行业内综合型高端人才较为稀缺，发行人通过多年积累和发展，已培养出既具备专业水平又对市场及客户需求有深刻理解的核心技术团队。此外，发行人管理层、中层管理干部及核心技术人员结构较为稳定，为发行人的稳定发展奠定了坚实的基础。

综上，本保荐机构认为发行人具有良好的发展前景。

十一、关于发行人审计截止日后经营状况的核查情况

经核查，保荐机构认为，自审计截止日至本发行保荐书签署日，发行人所处行业的产业政策、税收政策、业务模式及竞争趋势、主要客户或供应商、重大合同条款或实际执行情况、对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项、重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均不存在重大不利变化。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳和美精艺半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签章页）

项目协办人：

王越

王越

保荐代表人：

王泽洋

王泽洋

宋江龙

宋江龙

保荐业务部门负责人：

李靖

李靖

内核负责人：

华央平

华央平

保荐业务负责人：

毛剑锋

毛剑锋

保荐机构总经理：

李刚

李刚

保荐机构法定代表人（董事长）：

李刚

李刚



开源证券股份有限公司

2023年12月21日

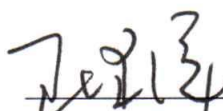
开源证券股份有限公司
关于深圳和美精艺半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市项目
保荐代表人专项授权书

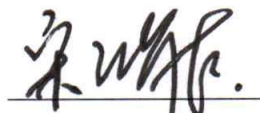
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件受理》及有关文件的规定，开源证券股份有限公司作为深圳和美精艺半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，授权王泽洋、宋江龙同志担任保荐代表人，具体负责该公司本次发行上市的尽职保荐及持续督导等工作。

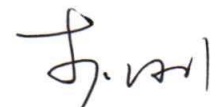
特此授权。

保荐代表人：


王泽洋


宋江龙

法定代表人（董事长）：


李 刚

